

참가비

구분	1부스/9㎡ (세금 포함)
일반	410,000엔 (442,800엔)
회원 ¹⁾	350,000엔 (378,000엔)
기타 비용	
코너 부스 비용 (코너 한 개 당) ²⁾	15,000엔 (16,200엔)

신청방법

귀사의 참가 제품, 기술, 서비스에 따라 참가 전시회를 선택하시어 별첨의 전시회 「참가 신청서」 뒷면의 「참가 규약」을 확인하신 후, 「참가 신청서」에 필요사항을 기재하여 운영사무국으로 송부하여 주십시오. 참가 신청서를 수리하는대로 청구서를 발행해 드리오니, 기재된 기일까지 입금 부탁드립니다. (원칙 회기 전 입금)

신청 마감

신청 마감일	2018년 2월 9일 (금)
--------	-----------------

취소 수수료

참가 신청자의 사정으로 전시회 참가를 취소하는 경우 (전부 또는 일부)에는 아래와 같이 취소 수수료를 받습니다.

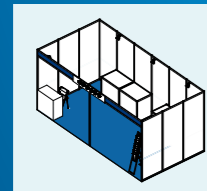
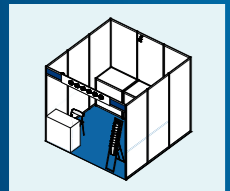
서면으로 취소 통지를 수리한 날	취소 수수료
2018년 2월 23일 (돈) 까지	부스 요금의 50%
2018년 2월 24일 (토) 까지	부스 요금의 100%

참고) 패키지 부스

합리적인 가격으로 기본 비품을 세팅할 수 있는 패키지 부스가 있습니다.

1개 부스 / 1면 개방 플랜
81,000 엔

2개 부스 / 1면 개방 플랜
127,440 엔



세트 아이템	1개 부스	2개 부스
파라넷	일식	일식
카펫	9㎡	18㎡
회사명 표시	일식	일식
형광등 40W	1개	2개
스포츠 라이트 100W	2개	4개
콘센트 100V	한 곳	한 곳
간선 공사	1.3kw	1.6kw
접수 세트	일식	일식
전시대	2개	4대
카탈로그 스탠드	1개	일식

※상기 요금은 장식요금이며, 참가비도 따로 부과됩니다.

※사양, 가격은 변동될 수 있습니다.

※자세한 사항 및 신청 방법은 3 전시회 참가자 설명회에서 안내해 드립니다.

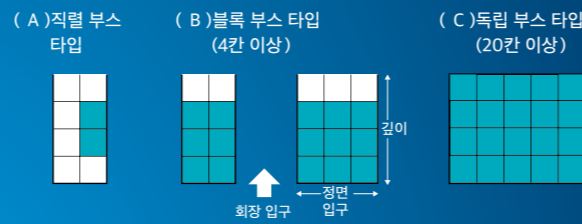
일정(예정)

2월	3월	4월	5월	6월
2/9 (토) 출전 신청 마감	3/9 (토) 출전 설명회 특 (자)은 (방) 위치 선택 회	4월 상순 초대장 배포 (예정) 4월 하순 각종 제출서류 기한 방문 사전등록 시작		6/4 (월) ~ 6/5 (화) 반입 기간 6/6 (수) ~ 6/8 (금) 전시회 개최

참가에 관한 문의 및 신청은 본부사무국 또는 운영사무국으로

- *1 대상 : WECC 회원 (JPCA, EIPC, HKPCA, IPC, IPCA, KPCA, TPCA)
- *2 부스 위치 결정 시, 코너 부스를 선택하실 수 있습니다. ※수량이 한정되어 있으므로 서둘러 신청하여 주십시오. ※코너 부스를 신청하실 경우, 개방면은 하기와 같습니다.
 - 직렬 : 2면 개방 (코너부스 한 개)
 - 블록 : 3면 개방 (코너부스 두 개)
- ※ 코너 부스의 요금은 부스 위치 선택 회의 후, 코너 부스 밖에 남아 있지 않을 경우 등 결과적으로 코너 부스를 사용할 경우에도 적용됩니다.
- ※ 도쿄 2020 올림픽 및 패럴림픽 경기 대회 개최가 회장 이용 등에 영향이 있을 것으로 예상되는 기간 (2019년 이후)에는 부스 수 증가로 인한 할인, 각 기업의 신문 구독자 할인 등 변경 가능성이 있습니다. 미리 양해 바랍니다.
- ※ 대형 부스 할인에 대한 자세한 내용은 운영 사무국 (03-5657-0767)으로 문의해 주십시오.

부스 형태



※ 희망하시는 부스 타입 및 코너 부스를 배정하기 어려울 수 있으므로, 미리 신청해 주시기 바랍니다.

부스 위치의 결정

전시회 참가자 설명회 개최일 (2018년 3월 9일 (금) 예정)에 부스 위치를 결정합니다.

전자 기기 토탈 솔루션전 공식 Twitter

회사 정보와 신제품 및 신기술을 공유하시지 않겠습니까?



전자 기기 토탈 솔루션전 공식 트위터가 개설되었습니다. 전시회와 업계 정보를 다양하게 보내드릴 예정이니 꼭 팔로우하세요.

해시 태그 '#JS_2018' 을 검색 또는 트윗해 주시기 바랍니다.



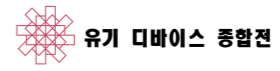
제 48 회 국제 전자 회로 산업 전



제 32 회 최첨단 실장 기술, 패키징 전시회



제 20 회 실장 프로세스 테크놀로지 전시회



IoT 대응 반도체 및 회로 기판전



전기 및 광전송 기술전



Smart Sensing 2018



탑재, 연결, 제조, 그리고 확장

6.6 Wed. → 6.8 Fri.
Tokyo Big Sight East Hall 4-8

전시회 참가 안내

전자기기 2018
토탈 솔루션전시회에서

www.jpccashow.com

본부사무국

일반사단법인 일본전자회로공업회

Secretariat Office

JTB Communication Design, Inc.

Celestine Shiba Mitsui Building, 3-23-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-8335
TEL: +81-3-5657-0767 FAX: +81-3-5657-0645 E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp



전자기기토탈 솔루션전시회에서 2018

IoT, 자동차, 로봇, 의료, 웨어러블 등을 구현하는 기술 종합 전시회

일렉트로닉스 전시회 중에서도 전문성, 관심도가 높고, 국내외에서 수많은 방문객을 맞이하여, 활발한 교류와 상담의 장을 마련, 전시회 참가자 여러분의 비즈니스를 지원합니다.

주 최 : 일반사단법인 일본전자회로공업회, 일반사단법인 일렉트로닉스 실장학회, 일반사단법인 일본로봇공업회
 공동주최 : 전자 디바이스산업신문 ((주) 산업타임즈사), 전선신문 ((주) 공업통신) JTB Communication Design, Inc.
 후원 : 경제산업성, 독립행정법인 중소기업기반정비기구 관동본부(이상 예정)

해외 협력 : 세 계전자회로업계 단체협의회 (WECC) 가맹 단체
 CPCA(중국 PCB 협회), EIPC(유럽 PCB 협회), HKPCA(홍콩 PCB 협회), IPC(미국 PCB 협회), IPCA(인도 PCB 협회), ELCINA(인도 전자 공업회), KPCA(한국전자회로산업협회), TPCA(대만 PCB 협회)

동시 개최전 : ANEX2018 (아시아 부직포 산업 종합 전시회 및 콘퍼런스)
 주 최 : 아시아 부직포 협회/일본 부직포 협회
 출전자수 : 350회사 (예정)
 방문자수 : 20,000회사 (예정)

2018. 6. 6 Wed. ▶ 6. 8 Fri. 도쿄 빅사이트 동관 4-8 홀

2017년 실적

참가 규모

456 개사 / 1,355 부스

방문객 수

43,184 명

세미나 청강자 수

11,210 명

전시회 레이아웃안

- 98%의 기업이 참가한 성과가 있다고 응답 (참가자 설문 조사 결과)
- 90% 이상의 방문객들이 다음 방문을 예정 (방문객 설문 조사 결과)
- 202건의 신제품 및 신기술을 전시회에서 발표



무료

참가자 프레젠테이션

부스 전시와 더불어 세미나 회장(전시회장 내)에서 참가자는 무료로 신제품 및 신기술을 홍보하실 수 있습니다.

- 1타임 30분
- 발표용 기기 완비
- 세미나 접수 직원 배치

※ 강연 날짜는 신청 선착순대로 정해집니다.

무료

프레스 센터 활용

전시회 기간에 프레스 센터를 설치합니다!!

- 신제품 및 서비스에 대한 보도용 발표 장소로 활용해 주십시오. (각 기업당 10분 정도 예상)

- 보도 자료 배포 가능

※ 일정은 참가자 설명회(3/9)에서 안내해드립니다.

주요 방문 기업

- 자동차 관련 : 아이신 세이키, 아사히 덴소, 이치코 공업, 칼소닉칸세이, 게이힌, 고이토 제작소, 스탠리 전기, 스미토모 덴소, 다이하쓰 공업, 덴소, 도카이리카, 도요 덴소, 도요타 자동차, 닛산 자동차, 니혼하쓰즈, 파이오니아, 히타치 오토 모티브 시스템즈, 히노 자동차, SUBARU, 혼다 기연공업, 마쓰다, 미쓰비시 자동차 공업, 야자키 부품
- OA 및 로봇틱스 : 오므론, 캐논, 사이버다인, 산요 전기, 파나소닉, 파나소닉 스마트 팩토리 솔루션즈, 화낙, 후지 제록스, 미쓰비시 전기, 야스카와 전기, 아마하 발동기, 리코 인더스트리, 리코 재팬
- 정보·통신 관련 : 애플, 인텔, NHK 미디어 테크놀로지, NTT, NTT 도코모, 오키 전기공업, 한국방송공사(KBS), 교세라, KDDI, 소프트뱅크, 도쿄 방송 홀딩스(TBS), 일본 IBM, 일본 전기, 일본 마이크로 소프트, 파나소닉, 히타치 제작소, Huawei, 후지쿠라, 후지쓰, 무라타 제작소
- A·V·가전 관련 : LG전자, 카시오 계산기, 캐논, Samsung Electronics, 사프, 소니, 소니 글로벌 매뉴팩처링&오퍼레이션즈, 소니 세미컨덕터 솔루션즈, 니콘, 파이오니아, 파나소닉, 후지쓰 제너럴, 아마하, 플렌드
- 의료기기 관련 : 올림푸스, Siemens, 시마즈 제작소, 시라카와 올림푸스, 테루모, 도시바 메디컬 시스템즈, 히타치 하이테크놀로지, 히타치 헬스케어 매뉴팩처링, 마크 전자, 모리타 도쿄 제작소
- 반도체 디바이스 관련 : 인텔, 캐논, 삼성전자, SCREEN 홀딩스, 소니, TDK, 도쿄 일렉트론, 도시바 메모리, 니콘, 히타치 하이테크놀로지즈, 후지쓰 세미컨덕터, 마이크로 재팬, 르네사스 일렉트로닉스, 로움
- 항공·우주 관련 : NEC 스페이스 테크놀로지, JAXA(우주항공연구개발기구), 신포니아 테크놀로지, 일본 아비오닉스, 일본 전기, 파나소닉, 미쓰비시 중공업, 미쓰비시 전기
- 기타 : 해상 자위대, 육상 자위대
- 전자회로기판 : 어드반테스트, 이스턴, 이비덴, 에루나, 교에이 산업, 교사, 교세라, 교덴, 시라이 전자공업, 신코 제작소, 신코 전기공업, 스미토모 덴코 프린트 서킷, 다이쇼 전자, 닛토 덴코, 일본 CMK, 일본 맥트론, 파나소닉, 히타치카세이, 후지쿠라, 후지쓰 인터커넥트 테크놀로지즈, 메이코, 아마시타 머티어리얼, 리소 공업

구성 전시회, 참가 대상

<p>전자회로기술</p>  <p>제 48 회 국제 전자 회로 산업 전</p>	<p>고밀도 구현 기술</p>  <p>제32회 최첨단 실장기술, 패키징 전시회</p>	<p>전자 부품 구현기</p>  <p>제20회 실장 프로세스 테크놀로지 전시회</p>	<p>신규 회로 형성 기술</p>  <p>IoT 대응 반도체 및 회로 기판전</p>	<p>전기 및 광전송 기술</p>  <p>전기 및 광전송 기술전</p>	<p>센서 기술</p>  <p>Smart Sensing 2018</p>
---	--	--	---	--	--